

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2021]32 号

关于延期召开 2021 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会 材料分技术委员会年会的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

因疫情防控要求，原定于 2021 年 11 月 16 日～11 月 19 日在云南省昆明市召开的 2021 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会年会（见半材标委[2021]27 号）延期至 2021 年 12 月 20 日～12 月 23 日举行，会议地点不变，请全体委员务必出席会议，同时请各会员单位、各起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议日程和会议内容

- 1、12 月 20 日，全天报到。
- 2、12 月 21 日，上午 8:30～12:00 举行全体大会，会议内容如下：
 - ① 领导讲话。
 - ② 全国半导体材料标准化分技术委员会秘书处作 2021 年度工作报告。
 - ③ 表彰 2021 年度全国半导体材料分标委会“技术标准优秀奖”、“特殊贡献奖”和“先进工作者”。
 - ④ 行业技术交流及研讨。
- 3、12 月 21 日，下午 14:00～18:00 继续全体大会，会议内容如下：
 - ① 终审 2021 年度审定完成的标准项目。
 - ② 讨论半导体材料领域国家标准体系优化工作。
 - ③ 论证 2022 年度半导体材料标准计划项目。请所有项目提出单位按照《关于征集 2021 年度全国半导体材料标准化分技术委员会年会论证的标准计

划项目的通知》（半材标委[2021]24 号）的要求，提前准备相关论证材料。秘书处将于年会前汇总所有需要论证的新计划项目，会议期间原则上不再接收新项目建议。

4、12 月 22 日，上午 8:30 开始分组会议，会议内容如下：

对《硅片表面光泽度的测试方法》等 10 项半导体材料国家、行业 and 协会标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请各标准负责起草单位于 12 月 13 日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 12 月 17 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2021 年 12 月 20 日。

2、报到地点：昆明花之城豪生国际大酒店（云南省昆明市盘龙区金瓦路 8188 号，0871-65036999）。

3、乘车路线：①昆明长水国际机场：乘坐地铁 6 号线至东部汽车站下车，步行 200 米至东部交通枢纽站，乘坐 K9 路至花之城广场站下车即到；全程约 20 公里，打车费用约 70 元。②昆明南站：乘坐地铁 1 号线至斗南站下车，换乘地铁 4 号线至菊花站下车，换乘地铁 6 号线至东部汽车站下车，步行 200 米至东部交通枢纽站，乘坐 K9 路至花之城广场站下车即到；全程约 35 公里，打车费用约 100 元。③昆明火车站：乘坐地铁 1 号线至环城南路站下车，换乘地铁 2 号线至塘子巷站下车，换乘地铁 6 号线至东部汽车站下车，步行 200 米至东部交通枢纽站，乘坐 K9 路至花之城广场站下车即到；全程约 15 公里，打车费用约 50 元。

三、会务及联系人

本次会议由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：杨素心 010-62629312 15010981543。

李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫薇 010-62257692。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2021 年 12 月 13 日前登录会议报名系统 (<http://www.ysmeeting.net>) 注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费 850 元/人。为保障会议用房安排和会议资料的准备, 12 月 17 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明: 12 月半材年会 (个人汇款请备注单位名称)。汇款账户信息如下:

收款单位: 有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行: 中国光大银行北京中关村支行

账号: 0875 0812 0100 3010 18526

附件: 审定、预审和讨论的标准项目

重要提示:

- (1) 请参加会议的人员报名前向所在单位报备, 了解出发地及会议地具体防疫要求, 经主管领导或防疫主管部门审批通过后方可外出;
- (2) 疫情防控不容松懈, 请参会代表于参会途中、参会期间、返程途中务必按照相关疫情防控要求做好个人防护, 并配合相关部门的防疫工作;
- (3) 报到时, 请参会代表出示健康防疫码;
- (4) 因处于疫情高风险地区和中风险地区而无法出席会议的代表, 可提前将对标准的反馈意见以书面形式提交至秘书处。

二〇二一年十一月二十六日

抄报: 全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	相关单位	备注
第一组				
1	中色协科字[2020]8 号 2020-023-T/CNIA	多晶硅生产用氢气中金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	内蒙古通威高纯晶硅有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、新特能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、青海芯测科技有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等	审定
2	中色协科字[2020]8 号 2020-025-T/CNIA	半导体材料痕量杂质分析用高纯可溶性聚四氟乙烯器皿	江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、北京诚驿恒仪科技有限公司、苏州汉谱埃文材料科技有限公司、集萃新材料研发有限公司等	审定
3	中色协科字[2020]8 号 2020-026-T/CNIA	半导体硅材料行业用高纯丁腈手套	苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司、江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、苏州利得尔网络科技有限公司等	审定
4	国标委发[2020]53 号 20204891-T-469	硅片表面光泽度的测试方法	浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、有研半导体硅材料股份公司、麦斯克电子材料股份有限公司、浙江海纳半导体有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司、上海新昇半导体科技有限公司、徐州鑫晶半导体科技有限公司、浙江中晶科技股份有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所等	预审
5	国标委发[2020]53 号 20204895-T-469	硅锭、硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试非接触涡流感应法	内蒙古中环光伏材料有限公司、弘元新材料(包头)有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、宁夏协鑫晶体科技发展有限公司、晶科能源有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司、晶澳太阳能有限公司等	预审
第二组				
6	国标委发[2019]29 号 20193166-T-469	氮化镓单晶衬底片晶面曲率半径测试方法	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州纳维科技有限公司、中国电子科技集团第四十六研究所、东莞市中镓半导体科技有限公司、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、福建兆元光电有限公司、山西华晶恒基新材料有限公司、镓特半导体科技(上海)有限公司等	审定

序号	计划文号及编号	项目名称	相关单位	备注
7	国标委发[2020]37 号 20202882-T-469	金属锗化学分析方法 第 3 部分: 痕量杂质元素的测定 辉光放电 质谱法	广东先导稀材股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、峨眉山市峨半高纯材料有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、扬州宁达贵金属有限公司、衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司、有研国晶辉新材料有限公司等	审定
8	国标委发[2021]19 号 20211951-T-469	再生锗原料	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司、广东先导稀材股份有限公司、扬州宁达贵金属有限公司、北矿检测技术有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、武汉拓材科技有限公司、云南五鑫实业有限公司、朝阳金美镓业有限公司、有研国晶辉新材料有限公司等	讨论
9	国标委发[2021]19 号 20211950-T-469	半导体单晶晶向 测定方法	中国电子科技集团公司第四十六研究所、丹东新东方晶体仪器有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、中环领先半导体材料有限公司、广东先导稀材股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司、峨嵋半导体材料研究所、浙江海纳半导体有限公司、浙江省硅材料质量检验中心等	讨论
10	工信厅科函[2020]263 号 2020-1508T-YS	氮化镓化学分析方法 痕量杂质元 素含量的测定 辉 光放电质谱法	国标（北京）检验认证有限公司、东莞市中镓半导体科技有限公司、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州纳维科技有限公司、镓特半导体科技(上海)有限公司等	讨论